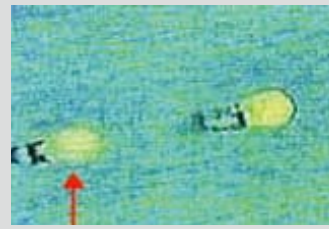


【原因・判断ポイント・発生工程】 静電気破壊により熔融した銅がリング状に飛散付着した部分に、SR が印刷されたことにより出来たもの（SR 印刷前～SR 印刷工程）

【原因、判断要点、发生工序】SR 印刷在因静电破坏，熔融的铜环状地飞溅并附着的部分所引起的（SR 印刷前～印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 Solder resist is coated on the area where copper was molten of electrostatic discharge, and splashed and deposited in the form of a ring. (Before solder resist application - solder resist application)



【コメント】
左のダム部に印刷されて出来たむら
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
左側の凹坑在印刷后出现的不均匀
显微镜倍率 ×

【Comments】
Uneven printing made by the dam on the left
Magnification: ×

2-3-2-8 SR 下地静電傷 / SR 基底的静电损伤 / Cut on the basis conductor under solder resist by electrostatic discharge

【特徴】 SR 下地の導体表面に三角形の導体熔融傷が見える状態の欠陥

【特征】 在 SR 基底的导线表面可见三角形的导体熔融伤痕的缺陷。

【Characteristics】 A triangular cut caused by molten conductor is observed on the basis conductor surface under solder resist

【原因・判断ポイント・発生工程】 SR 塗布前の導体表面が、静電気によって熔融破壊され、その上に SR が塗布したことにより出来たもの（SR 塗布前、SR 塗布工程）

【原因、判断要点、发生工序】 涂布 SR 前的导线面被静电破坏而熔融，SR 涂布在其上面就显示出来的（涂布 SR 前、涂布工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 The conductor surface before solder resist application is molten by electrostatic discharge. Solder resist is coated on this area causing the defect. (Previous processes - solder resist application)



【コメント】
顕微鏡倍率 × 175

【注釋】
显微镜倍率 × 1775

【Comments】
Magnification: ×175



【コメント】
顕微鏡倍率 × 175

【注釋】
显微镜倍率 × 175

【Comments】
Magnification: ×175

2-3-2-9 静電コータ塗布P SR 現像残 / 静电喷涂的 SR 显影残渣 / Photo solder resist residue after electrostatic coating

【特徴】 端子部などに、静電コータ塗布P SR が残っている状態の欠陥

【特征】 在插脚等残留静电喷涂 PSR 的缺陷。

【Characteristics】 Electrostatic coated photo solder resist is left on a edge board contact, etc.